

Dell PowerEdge 랙 서버는 IT 문제를 최소화하고 비즈니스 성공으로 이끄는 모던 인프라스트럭처를 구축할 수 있도록 지원합니다. QRG(Quick Reference Guide)에는 전체 랙 서버 포트폴리오에 대한 요약된 내용이 포함되어 있습니다.

랙 서버	R470	R570	R670	R770	R770AP	R6715	R7715	R6725	R7725	R7725xd	R4715	R5715
주요 특성	최적화된 단일 소켓 서버로 효율성과 경제성을 극대화하도록 특별히 설계되었으며, 클라우드 스케일 웹 및 앱 마이크로서비스, 데이터 서비스, 가상화 및 스케일 아웃 데이터베이스를 위한 강력한 성능을 제공합니다.	최적화된 단일 소켓 서버로 효율성과 경제성을 극대화하도록 특별히 설계되었으며, 클라우드 스케일 웹 및 앱 마이크로서비스, 데이터 서비스, 가상화 및 스케일 아웃 데이터베이스를 위한 강력한 성능을 제공합니다.	컴퓨팅 워크로드에 최적화된 개방형 생태계로, 고집적 구축, 클라우드 네이티브 애플리케이션 및 올플래시 SDS를 위해 전원을 최적화하고 균형 잡힌 성능을 제공하도록 설계되었습니다.	컴퓨팅 워크로드에 최적화된 개방형 생태계로, 가상화, 마이크로서비스, 클라우드 네이티브 애플리케이션, 대규모 분석 등에 최대의 성능과 전원 최적화를 제공합니다.	성능과 신뢰성을 모두 요구하는 엔터프라이즈 환경을 위해 특별 제작되었습니다. 대규모 워크로드를 실행할 수 있는 확장성, 운영 비용을 억제할 수 있는 효율성, 중요 데이터를 보호하는 보안을 제공하므로 엔터프라이즈 혁신을 위한 기본 서버입니다.	적합한 크기의 메모리 및 스토리지 집적도	향상된 성능과 가치	획기적인 성능 집적도	확장 가능한 획기적인 성능	스토리지 집적도가 높은 워크로드를 지원하도록 설계	중소규모 기업을 위한 강력한 성능, 유연성, 효율성을 제공하도록 설계	중소규모 기업을 위한 강력한 성능, 유연성, 효율성을 제공하도록 설계
타겟 워크로드	가상화, 스케일 아웃 데이터베이스, 빅데이터 및 분석, 고성능 컴퓨팅, 엣지 컴퓨팅	중간 밀도의 가상화, 스케일 아웃 데이터베이스, 빅데이터 및 분석, VDI, 고성능 컴퓨팅, 소프트웨어 정의 스토리지	가상화, 클라우드 네이티브 애플리케이션, 올플래시 SDS, 하이퍼스케일 워크로드, 스케일 아웃 데이터베이스	가상화, 인공 지능 추론, 클라우드 네이티브 애플리케이션, 하이퍼스케일 워크로드, 스케일 아웃 데이터베이스	HPC(High Performance Computing), 차세대 가상화 및 데이터 집약적 분석	데이터 분석, 고집적 가상화 및 소프트웨어 정의 스토리지	데이터 분석, 고집적 가상화 및 소프트웨어 정의 스토리지	HPC(High Performance Computing), VDI(Virtual Desktop Infrastructure) 및 가상화	HPC(High Performance Computing), VDI(Virtual Desktop Infrastructure) 및 가상화	오브젝트 스토리지	데이터 분석, 가상화, 스케일 아웃 데이터베이스, 엣지 컴퓨팅	가상화, 중간 수준의 VM 집적도 또는 VDI, 소매 영상 관제, 데이터 분석
프로세서 유형	1개의 인텔® 제온® 6 E-코어 프로세서(최대 144코어) 또는 1개의 인텔® 제온® 6 P-코어 프로세서(최대 86코어, R1S 옵션 포함)	2개의 인텔® 제온® 6 E-코어 프로세서(최대 144코어) 또는 2개의 인텔® 제온® 6 E-코어 프로세서(최대 86코어)	2개의 인텔® 제온® 6 E-코어 프로세서(최대 144코어) 또는 2개의 인텔® 제온® 6 E-코어 프로세서(최대 86코어)	2개의 인텔® 제온® 6 6900 Series 프로세서(P-코어, 최대 128코어)	1개의 AMD EPYC™ 5세대 9005 Series 프로세서, 최대 160개 코어	2개의 AMD EPYC™ 5세대 9005 Series 프로세서, 최대 192개 코어	2개의 AMD EPYC™ 5세대 9005 Series 프로세서, 최대 192개 코어	2개의 AMD EPYC™ 5세대 9005 Series 프로세서, 최대 192개 코어	2개의 AMD EPYC™ 5세대 9005 Series 프로세서, 최대 192개 코어	1개의 AMD EPYC™ 5세대 9005 Series 프로세서, 최대 32개 코어	1개의 AMD EPYC™ 5세대 9005 Series 프로세서, 최대 32개 코어	
DDR5 DIMM 슬롯 (최대 용량)	16(4TB)	16(4TB)	32(8TB)	24(3TB)	24(6TB)	24(6TB)	24(6TB)	24(6TB)	24(6TB)	24(3TB)	24(1.5TB)	24(1.5TB)
최대 디스크 드라이브 수:	4 x 3.5" 8 x 2.5" 10 x 2.5" 8개의 E3.S/16개의 E3.S 2개의 E3.S(후면)	8개의 2.5" 12 x 3.5" 16 x 2.5" 24 x 2.5" 8개의 E3.S/16개의 E3.S/32개의 E3.S 4개의 E3.S(후면)	2.5" 8개 2.5" 10개 8개의 E3.S/16개의 E3.S/20개의 E3.S 2개의 E3.S(후면)	2.5" 8개 2.5" 16개 2.5" 24개 8개의 E3.S / 16개의 E3.S(FIO Config) 32개의 E3.S/40개의 E3.S 4개의 E3.S(후면)	2.5" 8개 2.5" 16개 32개의 E3.S	4개의 3.5" 8개의 2.5" / U.2 10개의 2.5" 16개의 E3.S/20개의 E3.S 2개의 E3.S(후면)	2개의 U.2 8개의 2.5" / U.2 12개의 3.5" 16개의 2.5" 24개의 2.5" 8개의 E3.S/16개의 E3.S/32개의 E3.S/ 40개의 E3.S	4개의 3.5" 4개의 U.2 2.5" 8개 2.5" 10개 8개의 E3.S/16개의 E3.S/20개의 E3.S 2개의 E3.S(후면)	8개의 2.5" / U.2 12 x 3.5" 16개의 2.5" 24개의 2.5" 8개의 E3.S/16개의 E3.S/32개의 E3.S/ 40개의 E3.S	24개의 2.5" U.2 Gen5	4개의 3.5" 8개의 2.5" / U.2	12개의 3.5" 16개의 2.5"
최대 NVMe 드라이브 수:	16	32	22	44	32	22	40	22	40	24	8	해당 없음
최대 Gen5 PCIe 슬롯 수:	4	4	3	8	5	3	8	3	8	5*	3	4

랙 서버	R470	R570	R670	R770	R770AP	R6715	R7715	R6725	R7725	R7725xd	R4715	R5715
최대 Gen4 PCIe 슬롯 수:	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음
최대 가속기 지원:	4개의 75W SW	3개의 400W DW 또는 4개의 75W SW	3개의 75W SW	2개의 450W DW 또는 6개의 75W SW	해당 없음	3개의 75W SW	3개의 450W DW 또는 6개의 75W SW	3개의 75W SW	2개의 450W DW 또는 6개의 75W SW	해당 없음		
랙 높이(U)	1	2	1	2	2	1	2	1	2	2		
통합 보안	암호화 방식으로 서명된 펌웨어, 저장된 데이터 암호화(로컬 또는 외부 키 관리를 지원하는 SED), 보안 부팅, 보안 구성 요소 검증(하드웨어 무결성 검사), 칩 내장형 RoT(Root of Trust), 보안 삭제, System Lockdown(iDRAC10 Enterprise 또는 데이터 센터 필요), TPM 2.0 FIPS, CC-TCG 인증, 새시 침입 탐지					암호화 방식으로 서명된 펌웨어, 저장된 데이터 암호화(로컬 또는 외부 키 관리를 지원하는 SED), 보안 부팅, 보안 구성 요소 검증(하드웨어 무결성 검사), 보안 삭제, 칩 내장형 RoT(Root of Trust), System Lockdown, TPM 2.0 FIPS, CC-TCG 인증, AMD SME(Secure Memory Encryption), AMD SEV(Secure Encrypted Virtualization), 새시 침입 탐지						

참고: *별표(*)로 표시된 기능은 제품 출시 시점에 제공되지 않을 수 있습니다. 기능 가용성을 확인하려면 Dell.com의 제품 구성기 페이지를 참조하십시오.

Dell PowerEdge 랙 서버

빠른 참조 가이드

랙 서버	R760	R660	R7625	R6625	R7615	R6615	R660xs	R760xs	HS5610***	HS5620***
주요 특성	까다로운 애플리케이션을 위한 성능 및 다용성 제공	까다로운 애플리케이션을 위한 성능 및 다용성 제공	획기적인 성능	획기적인 성능	강력한 성능 및 확장성	최고 성능 및 우수한 TCO	가장 많이 사용되는 IT 애플리케이션에 적합한 크기	가장 많이 사용되는 IT 애플리케이션에 적합한 크기	컴퓨팅 워크로드에 최적화된 개방형 생태계	스토리지 고집적 워크로드에 최적화된 개방형 생태계
타겟 워크로드	혼합 워크로드 표준화, 데이터베이스 및 분석, 가상 데스크탑 인프라스트럭처	고밀도 가상화, 고집적 데이터베이스 분석, 혼합 워크로드 표준화	HPC(High Performance Computing), VDI(Virtual Desktop Infrastructure), 가상화	HPC(High Performance Computing), VDI(Virtual Desktop Infrastructure), 가상화	SDS(Software-Defined Storage), 가상화, Data Analytics	가상화, HCI(Hyper-Converged Infrastructure), NFV(Network Functions Virtualization)	가상화, 클라우드, 스케일 아웃 데이터베이스, HPC(High Performance Compute)	가상화, 소프트웨어 정의 스토리지, 중간 집적도 VM 또는 VDI	가상화, 스케일 아웃 데이터베이스, 소프트웨어 정의 스토리지 노드	가상화, 중간 규모 VM 집적도 또는 VDI, 소프트웨어 정의 스토리지 노드
프로세서 유형	2개의 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서(프로세서당 최대 56코어) 또는 2개의 5세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서(프로세서당 최대 64코어)		2개의 AMD EPYC™ 4세대 9004 시리즈 프로세서, 프로세서당 최대 128개 코어		1개의 AMD EPYC™ 4세대 9004 시리즈 프로세서, 최대 128개 코어		2개의 5세대 인텔® 제온®스케일러블 프로세서, 최대 28코어 또는 2개의 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서, 프로세서당 최대 32코어		2개의 5세대 인텔® 제온®스케일러블 프로세서, 최대 32코어 또는 2개의 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서, 프로세서당 최대 32코어	
DDR5 DIMM 슬롯 (최대 용량)	32(8TB)		24(6TB)		12(3TB)		16(1.5TB)	16(1.5TB)	16(2TB)	16(2TB)
최대 디스크 드라이브 수:	12개의 3.5" 8개의 2.5" 16개의 2.5" 24개의 2.5" 16개의 E3.S 2개의 2.5"(후면) 4개의 2.5"(후면) 4개의 E3.S(후면)	8개의 2.5" 10개의 2.5" 10개의 2.5" 14개의 E3.S 16개의 E3.S 2개의 2.5"(후면) 2개의 E3.S(후면)	8개의 3.5" 12개의 3.5" 8개의 2.5" 16개의 2.5" 24개의 2.5" 2개의 2.5"(후면) 4개의 2.5"(후면) 4개의 E3.S(후면)	4개의 3.5" 8개의 2.5" 10개의 2.5" 14개의 E3.S 16개의 E3.S 2개의 2.5"(후면) 2개의 E3.S(후면)	8개의 3.5" 12개의 3.5" 8개의 2.5" 16개의 2.5" 24개의 2.5" 2개의 2.5"(후면) 4개의 2.5"(후면) 4개의 E3.S(후면)	4개의 3.5" 8개의 2.5" 10개의 2.5" 14개의 E3.S 16개의 E3.S 2개의 2.5"(후면) 2개의 E3.S(후면)	4개의 3.5" 8개의 2.5" 10개의 2.5" 2개의 2.5"(후면)	12개의 3.5" 8개의 3.5" 8개의 2.5" 16개의 2.5" + 8개의 NVMe 2개의 2.5"(후면)	4개의 3.5" 8개의 2.5" 6개의 NVMe 10개의 2.5" 2개의 2.5"(후면)	12개의 3.5" 8개의 3.5" 8개의 2.5" 16개의 2.5" + 8개의 NVMe 2개의 2.5"(후면)
최대 NVMe 드라이브 수:	24	10	24	10	24	10	10	8	10	8
최대 Gen5 PCIe 슬롯 수:	4	2	4	2	4	2	2	2	2	2
최대 Gen4 PCIe 슬롯 수:	8	3	8	3	4	3	3	4	3	4
최대 가속기 지원:	2개의 350W DW 또는 6개의 75W SW	3개의 75W SW	2개의 300W DW 또는 6개의 75W SW	3개의 75W SW	3개의 300W DW 또는 6개의 75W SW	3개의 75W SW	해당 없음	2개의 75W SW	해당 없음	2개의 75W SW
랙 높이(U)	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2
통합 보안	TPM 2.0 FIPS, CC-TCG 인증, TPM 2.0 China NationZ, 암호화 방식으로 서명된 펌웨어, 새시 침입 알림, 보안 부팅 표준 보안, 칩 내장형 RoT(Root of Trust), System Lockdown(iDRAC9 Enterprise 또는 데이터 센터 필요), 저장된 데이터 암호화(로컬 또는 외부 키 관리 기능이 있는 SED) 보안 구성 요소 검증(하드웨어 무결성 검사) 및 모든 랙에서 System Erase			TPM 2.0 FIPS, CC-TCG 인증, TPM 2.0 China NationZ, 암호화 방식으로 서명된 펌웨어, 보안 부팅, 보안 삭제, 칩 내장형 RoT(Root of Trust), System Lockdown(iDRAC9 Enterprise 또는 데이터 센터 필요), AMD SME(Secure Memory Encryption) 및 AMD SEV(Secure Encrypted Virtualization)			TPM 2.0 FIPS, CC-TCG 인증, TPM 2.0 China NationZ, 암호화 방식으로 서명된 펌웨어, 새시 침입 알림, 보안 부팅 표준 보안, 칩 내장형 RoT(Root of Trust), System Lockdown(iDRAC9 Enterprise 또는 데이터 센터 필요), 저장된 데이터 암호화(로컬 또는 외부 키 관리 기능이 있는 SED) 보안 구성 요소 검증(하드웨어 무결성 검사) 및 모든 랙에서 System Erase			

참고: *별표(*)로 표시된 기능은 제품 출시 시점에 제공되지 않을 수 있습니다. 기능 가용성을 확인하려면 Dell.com의 제품 구성기 페이지를 참조하십시오.

*** HS560 및 HS5620은 일부 고객을 위한 Hyperscale Next 프로그램을 통해서만 제공됩니다.









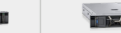
랙 서버	R960	R860	R760xa	R760xd2	R360	R260
주요 특성	비즈니스 연속성 및 스케일 아웃을 위한 탁월한 가속화	강력한 비즈니스 크리티컬, 고밀도 컴퓨팅 코어 워크로드	집약적인 GPU 애플리케이션을 위한 확장 가능한 고성능 서버	고집적 스토리지, 더 빠른 검색 및 확장성	생산성 효율화, 높은 엔터프라이즈 GPU 및 강력한 컴퓨팅으로 일반적인 비즈니스 애플리케이션을 지원합니다.	최신 인텔® 제온® 6300 Series 프로세서, DDR5 메모리, NVMe BOSS 및 Energy Star 4.0 PSU를 갖춘 근거리 엣지 고객을 위한 필터 베젤이 있는 짧은 깊이의 랙 서버
타겟 워크로드	대용량 인메모리 데이터베이스, 데이터 분석, AI 및 가상화, VDI(Virtual Desktop Infrastructure)		AI/ML/DL 교육 및 추론, 디지털 트윈, 렌더링 그래픽 가상화 및 VDI 그래픽	파일 및 오브젝트 스토리지, 비디오 캡처 및 관제, 비디오 스트리밍	협업 및 공유, 메일 및 메시징, 데이터베이스	협업 및 공유, 메일 및 메시징, 근거리 엣지 애플리케이션
프로세서 유형	4개의 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서(프로세서당 최대 60코어) 및 인텔® QuickAssist 기술 옵션 포함		2개의 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서(프로세서당 최대 56코어) 또는 2개의 5세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서(프로세서당 최대 64코어)	2개의 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서(프로세서당 최대 32코어) 또는 2개의 5세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서(프로세서당 최대 28코어)	1개의 인텔® 제온® 6300 Series 프로세서(최대 8코어) 또는 1개의 인텔® 제온® E-2400 Series 프로세서(최대 8코어) 또는 1개의 인텔® 펜티엄 프로세서(2코어)	1개의 인텔® 제온® 6300 Series 프로세서(최대 8코어) 또는 1개의 인텔® 제온® E-2400 Series 프로세서(최대 8코어) 또는 1개의 인텔® 펜티엄 프로세서(2코어)
DDR5 DIMM 슬롯(최대 용량)	64(16TB)		32(8TB)	16(1.5TB)	4(128GB)	4(128GB)
최대 디스크 드라이브 수:	8개의 2.5" 16개의 2.5" 24개의 2.5" 32개의 2.5" 16개의 E3.S 8개의 2.5" + 16개의 E3.S	8개의 2.5" 16개의 2.5" 24개의 2.5" 8개의 E3.S 2개의 2.5"(후면)	6개의 2.5" 8개의 2.5" 6개의 E3.S	12개의 3.5"(전면 베이) + 12개의 3.5"(중간 베이) 2개의 2.5" 또는 4개의 2.5" 또는 4개의 3.5" 또는 4개의 E3.S(후면)	4개의 3.5" 8개의 2.5" 6개의 2.5" SAS/SATA + 2개의 2.5" NVMe	2개의 3.5" 6개의 2.5" 4개의 2.5" 칩 SATA SSD(SW RAID) 4개의 2.5" 칩 SATA + 2개의 2.5" NVMe (SW RAID) 4개의 2.5" SAS/SATA + 2개의 2.5" NVMe(HW RAID)
최대 NVMe 드라이브 수:	24	24	8	4	2	2
최대 Gen5 PCIe 슬롯 수:	12	8	12	해당 없음	2	해당 없음
최대 Gen4 PCIe 슬롯 수:	해당 없음	4	해당 없음	5	2	2
최대 가속기 지원:	4개의 400W DW	해당 없음	4개의 400W DW 또는 12개의 75W SW	2개의 75W SW, 1개의 75W SW + 1개의 150W SW 또는 1개의 180W DW	1개의 60W SW	해당 없음
랙 높이(U)	4	2	2	2	1	1
통합 보안	TPM 2.0 FIPS, CC-TCG 인증, TPM 2.0 China NationZ, 암호화 방식으로 서명된 펌웨어, 새시 침입 알림, 보안 부팅 표준 보안, 칩 내장형 RoT(Root of Trust), System Lockdown(iDRAC9 Enterprise 또는 데이터 센터 필요), 저장된 데이터 암호화(로컬 또는 외부 키 관리 기능이 있는 SED) 보안 구성 요소 검증(하드웨어 무결성 검사) 및 모든 랙에서 System Erase					

랙 서버	XE7745	XE7740	XE9680L	XE9685L
주요 특성	AI 추론, 모델 미세 조정, HPC(High Performance Computing)를 위해 특별 제작된 내부 GPU 슬롯은 네트워크 연결을 위한 8개의 추가 Gen 5.0 PCIe 슬롯과 페어링되어 Dell PowerEdge R760xa에 비해 두 배의 DW PCIe GPU 용량으로 고밀도의 유연한 구성을 구현	AI 추론, 모델 미세 조정, HPC(High Performance Computing)를 위해 특별 제작된 내부 GPU 슬롯은 네트워크 연결을 위한 8개의 추가 Gen 5.0 PCIe 슬롯과 페어링되어 Dell PowerEdge R760xa에 비해 두 배의 DW PCIe GPU 용량으로 고밀도의 유연한 구성을 구현	4U 폼 팩터에서 직접 액체 냉각 CPU 및 GPU를 통해 탁월한 AI 교육 및 HPC 성능 제공	4U 폼 팩터에서 직접 액체 냉각 CPU 및 GPU를 통해 탁월한 AI 교육 및 HPC 성능 제공
타겟 워크로드	Gen AI 미세 조정, Gen AI 추론, 자연어 처리, 디지털 트윈 및 에이전트형 AI	Gen AI 미세 조정, Gen AI 추론, 자연어 처리, 디지털 트윈 및 에이전트형 AI	AI 교육, LLM 교육, 미세 조정 및 대규모 LLM 추론	AI 교육, LLM 교육, 미세 조정 및 대규모 LLM 추론
프로세서 유형	2개의 5세대 AMD EPYC™ 9005 Series 프로세서, 프로세서당 최대 192개 코어	2개의 5세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 (프로세서당 최대 56코어)	2개의 5세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 (프로세서당 최대 64코어)	2개의 5세대 AMD EPYC™ 9005 Series 프로세서, 프로세서당 최대 192개 코어
DDR5 DIMM 슬롯(최대 용량)	24(3TB)	24(3TB)	32(4TB)	24(3TB)
최대 디스크 드라이브 수:	8개의 E3.S	8개의 E3.S	8개의 2.5"	8개의 2.5"
최대 NVMe 드라이브 수:	해당 없음	해당 없음	8	8
최대 Gen5 PCIe 슬롯 수:	8	8	12	12
최대 Gen4 PCIe 슬롯 수:	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음
최대 가속기 지원:	8개의 600W SW 또는 16개의 75W SW	8개의 600W SW 또는 16개의 75W SW	8개의 NVIDIA HGX B200 180GB 1,000W SXM6 GPU, NVIDIA NVLink 기술과 완벽하게 상호 연결 가능	8개의 NVIDIA HGX B200 180GB 1,000W SXM6 GPU, NVIDIA NVLink 기술과 완벽하게 상호 연결 가능
랙 높이(U)	4	4	4	4
통합 랙	해당 없음	해당 없음	IR5000 필요	IR5000 필요
통합 보안	암호화 방식으로 서명된 펌웨어, 저장된 데이터 암호화(로컬 또는 외부 키 관리를 지원하는 SED)*, 보안 부팅, 보안 구성 요소 검증(하드웨어 무결성 검사), 보안 삭제, 칩 내장형 RoT(Root of Trust), System Lockdown(iDRAC10 Enterprise 또는 Datacenter 필요), TPM 2.0 FIPS, CC-TCG 인증, AMD SME(Secure Memory Encryption), AMD SEV(Secure Encrypted Virtualization)	새시 칩입 탐지, 암호화 방식으로 서명된 펌웨어, 저장된 데이터 암호화(로컬 또는 외부 키 관리를 지원하는 SED)*, 보안 부팅, 보안 구성 요소 검증(하드웨어 무결성 검사), 보안 삭제, 칩 내장형 RoT(Root of Trust), System Lockdown(iDRAC10 Enterprise 또는 Datacenter 필요), TPM 2.0 FIPS, CC-TCG 인증	암호화 방식으로 서명된 펌웨어, 저장된 데이터 암호화(로컬 또는 외부 키 관리를 지원하는 SED), 보안 부팅, 보안 구성 요소 검증(하드웨어 무결성 검사), 보안 삭제, 칩 내장형 RoT(Root of Trust), 시스템 잠금(iDRAC9 Enterprise 또는 Datacenter 필요), TPM 2.0 FIPS, CC-TCG 인증	암호화 방식으로 서명된 펌웨어, 저장된 데이터 암호화(로컬 또는 외부 키 관리를 지원하는 SED), 보안 부팅, 보안 구성 요소 검증(하드웨어 무결성 검사), 보안 삭제, 칩 내장형 RoT(Root of Trust), System Lockdown(iDRAC9 Enterprise 또는 Datacenter 필요), TPM 2.0 FIPS, CC-TCG 인증

참고: *별표(*)로 표시된 기능은 제품 출시 시점에 제공되지 않을 수 있습니다. 기능 가용성을 확인하려면 Dell.com의 제품 구성기 페이지를 참조하십시오.

랙 서버	XE9680	XE9640	XE8640	XR7620	XR5610
주요 특성	성능 저하 없는 고속 AI 교육 성능, H100 GPU를 선택할 수 있는 유연성, 최대 35C의 주변 온도를 지원하는 6U 2소켓	2U 폼 팩터에서 직접 액체 냉각 CPU 및 GPU를 통해 집적도에 최적화된 AI 및 HPC 성능 제공	더 빠른 ML/DL 교육 및 HPC 성능, 4U 2소켓 서버, 최대 35C 주변 온도, 표준 랙 깊이	엣지에 최적화된 고성능, 대용량이고 깊이가 낮은 2U 2소켓 서버	고성능, 낮은 깊이, 러기드, 역방향 마운팅, 필터링된 베젤, -5C~55°C 운영 온도
타겟 워크로드	대규모 모델 교육, 자연어 처리, 권장 엔진, 대화형 AI, 번역, 신약 개발	HPC 모델링 및 시뮬레이션, 지진 분석, 컴퓨터 유체 역학, 석유 및 가스, AI/ML 교육, 오브젝트 감지, 이미지 분류	HPC 모델링 및 시뮬레이션, 지진 분석, 컴퓨터 유체 역학, 석유 및 가스, AI/ML 교육, 오브젝트 감지, 이미지 분류	산업 자동화, 비디오 분석, POS(Point of Sale) 분석, AI 추론, 엣지 자산 데이터 집계 및 분석	vRAN, D-RAN, O-RAN, 산업 자동화, 비디오 분석, POS(Point of Sale) 분석, AI 추론, 엣지 자산 데이터 집계 및 분석
프로세서 유형	2개의 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서(프로세서당 최대 56코어) 또는 2개의 5세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서(프로세서당 최대 56코어)	2개의 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서(프로세서당 최대 56코어) 또는 2개의 5세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서(프로세서당 최대 64코어)	2개의 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서(프로세서당 최대 56코어) 또는 2개의 5세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서(프로세서당 최대 64코어)	2개의 5세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서(프로세서당 최대 16코어) 또는 2개의 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서(프로세서당 최대 32코어)	1개의 5세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서(프로세서당 최대 16코어) 또는 1개의 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서(프로세서당 최대 32코어)
DDR5 DIMM 슬롯(최대 용량)	32(4TB)	• 16(1TB) 인텔 GPU • 8, 16, 32(2TB) NVIDIA GPU	32(4TB)	16(1TB)	8(1TB)
최대 디스크 드라이브 수:	8개의 2.5" 16개의 E3.S	4개의 2.5"	8개의 2.5"	4개의 2.5" 8개의 E3.S	4개의 2.5"
최대 NVMe 드라이브 수:	8	4	8	4	4
최대 Gen5 PCIe 슬롯 수:	10	4	4	2	2
최대 Gen4 PCIe 슬롯 수:	해당 없음	해당 없음	해당 없음	5	해당 없음
최대 가속기 지원:	8개의 NVIDIA HGX H100 80GB 700W SXM5 GPU 또는 NVIDIA HGX H800 8-GPU SXM 80GB 700W GPU, NVIDIA HGX H200 8-GPU SXM 141GB 700W GPU, NVIDIA HGX H20 8-GPU SXM 96GB 500W GPU 또는 8개의 AMD Instinct MI300X 192GB 750W OAM GPU 또는 8개의 인텔 Gaudi3 128GB 900W OAM GPU	4개의 NVIDIA H100 SXM 7000W NVLINK GPU 또는 인텔 Data Center GPU Max Series 1550 OAM 600W Xelink GPU	4개의 NVIDIA HGX H100 80GB 700W SXM5 GPU, NVIDIA NVLink 기술과 완벽하게 상호 연결 가능	4개의 150W SW 또는 2개의 300W DW	2개의 75W SW
랙 높이(U)	6	2	4	2	1
통합 랙	선택 사항: IR5000	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음
통합 보안	TPM 2.0 FIPS, CC-TCG 인증, TPM 2.0 China NationZ, 구성 요소 검증 (하드웨어 무결성 검사) 및 모든 랙에서 System Erase	암호화 방식으로 서명된 펌웨어, 새시 침입 알림, 보안 부팅 표준 보안, 칩 내장형 RoT(Root of Trust), System Lockdown(iDRAC9 Enterprise 또는 데이터 센터 필요), 저장된 데이터 암호화(로컬 또는 외부 키 관리 기능이 있는 SED) 보안			

참고: *별표(*)로 표시된 기능은 제품 출시 시점에 제공되지 않을 수 있습니다. 기능 가용성을 확인하려면 Dell.com의 제품 구성기 페이지를 참조하십시오.

랙 서버	R750	R750xa	R650	R7525	R6525	R7515	R6515	R750xs	R650xs	R450	R550	XR11	XR12	R350	R250
주요 특성	 가장 까다로운 워크로드를 처리하는 우수한 성능	 고도로 집약적인 GPU 워크로드	 뛰어난 확장성, 최적화된 워크로드 성능	 강력한 성능 및 유연성	 고밀도 가상화	 강력한 성능 및 확장성	 고밀도 컴퓨팅	 성장형 스케일 아웃 솔루션을 위해 특별히 설계된 2U 서버	 빠르게 성장하는 고밀도 스케일 아웃 솔루션을 위해 특별히 설계된 완전한 성능을 갖춘 1U 서버	 가치 및 집적도 중심, 범용 IT용 제작	 다용성, 가치 최적화, 가상화 대비, 범용 IT를 위해 구축	 엣지 중심, 세로 길이가 짧고 견고함, 역순 마운팅 옵션 포함	 엣지 중심, 세로 길이가 짧고 견고함, 역순 마운팅 옵션 포함	 생산성 및 데이터 집약적인 애플리케이션을 위한 1U 서버의 강력한 성능	 공통 비즈니스 애플리케이션을 위한 강력한 컴퓨팅 및 생산성 향상
타겟 워크로드	데이터베이스 및 분석, HPC, 기존 기업 IT, VDI, AI 또는 ML 환경	AI, ML 또는 DL 교육 또는 추론, HPC, 가상화 환경	혼합 워크로드 표준화, 데이터베이스 및 분석, HFT, 기존 기업 IT, VDI, HPC, AI 또는 ML 환경	올플래시 SDS, VDI, Data Analytics	HPC, 고밀도 VDI, 가상화	SDS, 가상화, Data Analytics	가상화, HCI, NFV	가상화, 중간 수준의 VM 밀도 또는 VDI, 스케일 아웃 데이터베이스 워크로드	가상화, 클라우드, 스케일 아웃 데이터베이스 및 고성능 컴퓨팅 워크로드	소규모 IT 인프라스트럭처, 경량 VM, 소규모 기업 특정 워크로드	소규모 IT 인프라스트럭처, 경량 VM 밀도, 소규모 기업 특정 워크로드	Telco/5G(MEC, CDN, vRAN), 군용, 소매(분석 - 영상 관제/POS/IOT 집계)	Telco/5G(MEC, CDN, vRAN), 군용, 소매(분석 - 영상 관제/POS/IOT 집계)	중소 규모 기업, 원격 사무소/지사, 협업 및 공유, Data Analytics 및 가상화 워크로드	중소 규모 기업, 원격 사무소/지사, 협업 및 공유, 메일/메시징 및 파일/인쇄 워크로드
프로세서 유형	2개의 3세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서, 프로세서당 최대 40코어			2개의 2세대 또는 3세대 AMD EPYC™ 프로세서, 프로세서당 최대 64코어		1개의 2세대 또는 3세대 AMD EPYC™ 프로세서, 프로세서당 최대 64코어		2개의 3세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서, 프로세서당 최대 32코어		2개의 3세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서, 프로세서당 최대 24코어		1개의 3세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서, 프로세서당 최대 36코어		1개의 인텔 제온 E-2300 시리즈 프로세서, 최대 8코어 또는 1개의 인텔 펜티엄 프로세서, 최대 2코어	
DDR4 DIMM 슬롯 (최대 용량)	32(8TB)		32(4TB)			16(2TB)		16(1TB)				8(1TB)		4(128GB)	
최대 디스크 드라이브 수:	12개의 3.5" 8개의 2.5" 16개의 2.5" 24개의 2.5" 2개의 2.5" 또는 4개의 2.5"(후면)	6개의 2.5" 8개의 2.5"	4개의 3.5" 8개의 2.5" 10개의 2.5" 2개의 2.5"(후면)	12개의 3.5" 26개의 2.5"	4개의 3.5" 12개의 2.5"	12개의 3.5" 24개의 2.5"	4개의 3.5" 8개의 2.5"	8개의 3.5" 12개의 3.5" 8개의 2.5" 16개의 2.5" + 8개의 2.5"	4개의 3.5" 8개의 2.5" 10개의 2.5" 2개의 2.5"(후면)	4개의 3.5" 8개의 2.5"	8개의 3.5" 8개의 2.5"	4개의 2.5"	6개의 2.5"	4개의 3.5" 8개의 2.5"	4개의 3.5" 4개의 3.5"(케이블 연결됨) 2개의 3.5"(케이블 연결됨)
최대 NVMe 드라이브 수:	24	8	12	24	12	24	10	8	10	해당 없음		4	6	해당 없음	
최대 Gen4 PCIe 슬롯 수:	8	8	3	8	3	2	1	5	3	2	3	3	5	3	2
최대 Gen3 PCIe 슬롯 수:	해당 없음					2	1	1	해당 없음		1	해당 없음			
최대 가속기 지원:	2개의 300W DW 또는 4개의 150W SW 또는 6개의 75W SW	4개의 150W SW 또는 4개의 300W DW 또는 2개의 75W SW	3개의 75W SW	3개의 300W DW 또는 6개의 75W SW	3개의 SW	4개의 SW, 1개의 DW, 1개의 FPGA	1개의 SW	해당 없음				2개의 75W SW	2개의 75W 또는 150W SW 또는 2개의 300W DW	해당 없음	
랙 높이(U)	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	1
통합 보안	TPM 1.2/2.0 FIPS, CC-TCG 인증, TPM 2.0 China NationZ, 암호화 방식으로 서명된 펌웨어, 새시 침입 알림, 보안 부팅이 모든 랙의 표준 보안입니다. 실리콘 루트 오브 트러스트, System Lockdown(iDRAC9 Enterprise 또는 Datacenter 필요), System Erase 등의 통합 보안 기능은 모든 랙에 적용됩니다.														

랙 서버	R940	R940xa	R840	R740xd	R740	R740xd2	R640	R540	R440	R340	R240
주요 특성	강력한 성능	극한의 성능	Data Analytics 속도 대폭 향상	확장 가능한 스토리지 성능	최적의 애플리케이션 성능	엔터프라이즈 콘텐츠 서버	성능 및 집적도	밸런스 및 적응성	스케일 아웃 컴퓨팅	비즈니스 성장 가속화	단순한 컴퓨팅 환경
타겟 워크로드	메모리 내 데이터베이스	GPU 데이터베이스 가속화, 머신 러닝	데이터 집약적 워크로드, HFT, 고밀도 가상화	SDS, 서비스 공급업체, 빅데이터 서버	VDI 및 클라우드 워크로드	미디어 스트리밍, SDS	고밀도 스케일 아웃 데이터 센터 컴퓨팅 및 스토리지	메일 메시지 및 가상화	HPC, 웹 기술, 스케일 아웃 인프라스트럭처	ROBO 생산성 및 데이터 집약적 애플리케이션	소규모 기업 및 서비스 공급업체 워크로드
프로세서 유형	4개의 2세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서			2개의 2세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서						1개의 인텔 제온 E-2200, 인텔 코어 i3®, 인텔 펜티엄® 또는 인텔 셀러론® 프로세서	
DDR4 DIMM 슬롯(최대 용량)	48(15.36TB)			24(7.68TB)		16(1TB)	24(7.68TB)	16(1TB)		4(64GB)	
최대 디스크 드라이브 수:	24개의 2.5"	32개의 2.5"	26개의 2.5"	18개의 3.5" 32개의 2.5"	8개의 3.5" 16개의 2.5"	26개의 3.5" 16개의 3.5" + 10개의 2.5" ²	4개의 3.5" 12개의 2.5"	14개의 3.5"	4개의 3.5" 10개의 2.5"	4개의 3.5" 8개의 2.5"	4개의 3.5" 4개의 2.5" ²
최대 NVMe 드라이브 수:	12	4	24	해당 없음		10	해당 없음		4	해당 없음	
최대 Gen4 PCIe 슬롯 수:	해당 없음										
최대 Gen3 PCIe 슬롯 수:	13	12	6	8	5	3	5	2	2	해당 없음	
최대 가속기 지원:	해당 없음	4개의 DW GPU 또는 4개의 DW 또는 8개의 SW FPGA	2개의 DW GPU 또는 2개의 SW 또는 DW FPGA	3개의 DW 또는 6개의 SW GPU 또는 3개의 DW 또는 4개의 SW FPGA	해당 없음		1개의 SW GPU 또는 1개의 SW FPGA	해당 없음			
랙 높이(U)	3	4	2				1	2	1	1	
통합 보안	TPM 1.2/2.0 FIPS, CC-TCG 인증, TPM 2.0 China NationZ, 암호화 방식으로 서명된 펌웨어, 새시 침입 알림, 보안 부팅이 모든 랙의 표준 보안입니다. 실리콘 루트 오브 트러스트, System Lockdown(iDRAC9 Enterprise 또는 Datacenter 필요), System Erase 등의 통합 보안 기능은 모든 랙에 적용됩니다.										

¹ 일부 기능을 사용할 수 없는 플랫폼도 있습니다.

² 드라이브는 하이브리드 캐리어를 사용하여 3.5" 드라이브 베이에 맞춥니다. (R740xd2의 경우 2.5" SSD가 최대 10개인 하이브리드 구성을 사용할 수 있습니다.)

제로 트러스트 IT 환경 및 운영을 위한 사이버 회복탄력성을 갖춘 아키텍처

보안은 보호된 공급망과 공장-현장 무결성 보장을 포함하여 PowerEdge 수명주기의 모든 단계에 통합됩니다. 칩 내장형 RoT(Root of Trust)는 포괄적인 부팅 회복탄력성을 보장하며, MFA(Multi-Factor Authentication)와 역할 기반 액세스 제어는 운영의 신뢰성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

지속 가능성

제품 및 패키징의 재활용 자재부터 에너지 효율성을 위한 신중하고 혁신적인 옵션에 이르기까지 PowerEdge 포트폴리오는 탄소 배출량을 줄이고 운영 비용을 절감할 수 있도록 제품을 제작, 제공 및 재활용할 수 있게 설계되었습니다. Dell Technologies를 통해 기존 시스템을 책임감 있게 폐기할 수도 있습니다.

자율 운영 인프라스트럭처로 효율성 증가 및 운영 가속

Dell OpenManage Systems Management 포트폴리오는 IT 인프라스트럭처 관리 및 보안의 복잡성을 줄여줍니다. Dell Technologies의 직관적인 엔드투엔드 툴을 사용하는 IT는 성장하는 비즈니스에 집중하기 위해 프로세스와 정보 사일로를 줄여 안전하게 통합된 경험을 제공할 수 있습니다. Dell OpenManage 포트폴리오는 혁신 원동력의 핵심으로, 기술 환경을 확장하고 관리하며 보호하는 톨과 자동화로 사용자를 안내합니다.

더욱 안심할 수 있는 Dell Technologies Services

어디에 있든 고객을 만족시킬 수 있도록 설계된 포괄적인 서비스를 통해 PowerEdge 서버를 극대화하십시오. [전문 AI 서비스](#)를 통해 많은 AI 활용 사례의 달성에서 가치 실현 시간을 가속하고, [ProDeploy Suite](#)를 활용하여 맞춤형 배포 옵션을 선택하며, [ProSupport Suite](#)로 사전 예방적이고 예측 가능한 지원을 받을 수 있습니다. 또한 170개 지역에서 60,000명이 넘는 직원과 파트너가 지원하는 다양한 서비스를 이용할 수 있습니다.

PowerEdge 서버 자세히 알아보기



PowerEdge 서버 서비스에 관한 자세한 정보



시스템 관리 솔루션에 관한 자세한 정보



리소스 라이브러리 검색



X(이전 Twitter)에서 PowerEdge 서버 팔로우하기



Dell Technologies 전문가에게 영업 또는 지원 문의하기



LinkedIn에서 PowerEdge 팔로우하기